

<<半导体工程学>>

图书基本信息

书名：<<半导体工程学>>

13位ISBN编号：9787030093226

10位ISBN编号：7030093224

出版时间：2001-06-01

出版时间：科学出版社

作者：孙健霞 樊友民

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<半导体工程学>>

内容概要

本书主要讲解半导体工程学基础、半导体中的电子和空穴、载流子输送现象、pn结和金属-半导体接触、二极管和双极晶体管、金属-绝缘体-半导体结构基础等。书中内容新颖，重点突出，文字叙述深入浅出，济畅易懂。

<<半导体工程学>>

书籍目录

1 半导体工程学基础

1.1 半导体的种类

1.2 半导体的特征

练习题

2 半导体中的电子和空穴

2.1 晶体结构和原子及固体的电子能量

2.2 固体(晶体)中的电子、空穴运动

2.3 本征半导体和杂质半导体

2.4 热平衡的载流子浓度

练习题

3 载流子输运现象

3.1 导电现象

3.2 霍尔效应

3.3 非平衡状态下的载流子输运现象

3.4 扩散方程式

练习题

4 pn结和金属-

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>